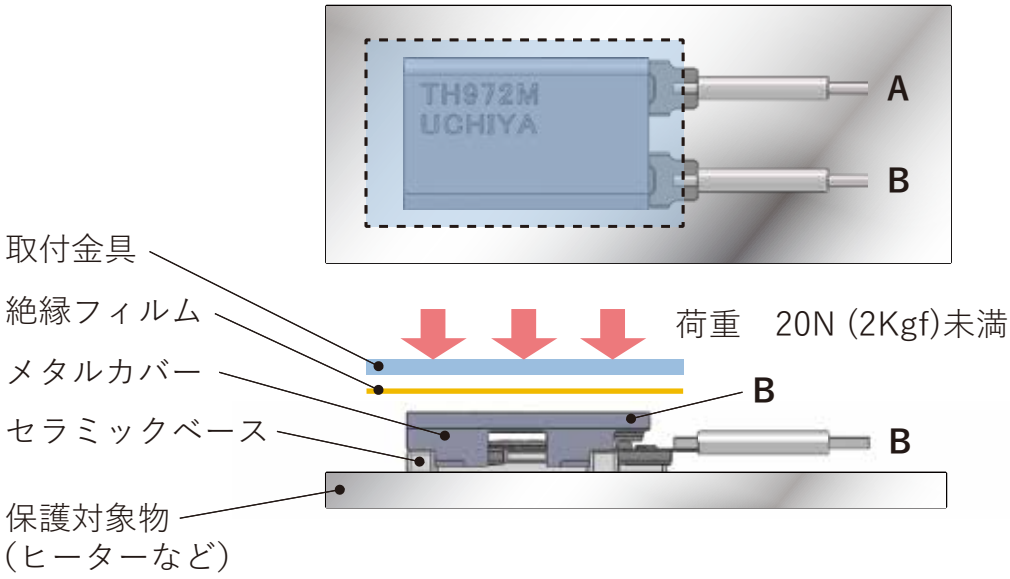
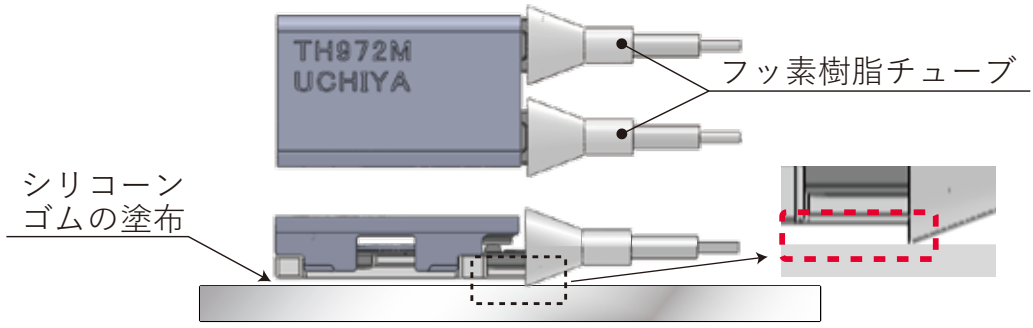
UCHIYA

TH972M
取 付 方 法



- TH972Mは構成部品にセラミックベースを使用しています。セラミックベースの底面は、平面に置いたときの隙間が0.05mm以内となる平面度です。完全な平面でないため、セラミックベースに過度な荷重が掛かると、セラミックベースが割れる可能性があります。
- TH972Mを取付金具などで固定する場合は、TH972Mを保護対象物（ヒータなど）の平面に設置し、メタルカバーよりも大きな面積を有する取付金具の平面と接触させ、その時の荷重は20N(2kgf)未満としてください。
- 保護対象物とセラミックベースの間にシリコーンゴムを塗布すると、熱伝導向上や、接触面の凹凸の緩和、取付時の加圧ストレス軽減を行うことができます。
  [シリコーンゴム推奨品]
  信越化学工業株式会社　一液型液状ゴム（RTVゴム）　低分子シロキサン低減品　KE-3493
  ・接点障害を引き起こす低分子シロキサンが低減している商品
  ・-50°C～+250°Cでの使用可能（異常時の短時間の温度上昇であれば+300°Cの耐熱を有する）
- リード線接続部の保護の目的でフッ素樹脂チューブを取り付けると、セラミックベースの底面よりフッ素樹脂チューブが取付面側に突出し段差ができる場合があります。この段差を埋めるためにもシリコーンゴムを使用することができます。



- その他の取付方法として、TH972Mをポリイミドフィルム（カプトン®など）で絶縁対策を兼ねて巻き、取付金具で軽く押さえるという方法もあります。接点が閉じている時はメタルカバーには電位が印加されませんが、接点が開いた時、メタルカバーにB側の電位が印加されます。必要に応じて、適切な絶縁フィルムでメタルカバーを絶縁してください。
- いずれの場合におきまして、お客様のご使用条件のもとで、適切に保持されていることをご確認ください。振動環境でのご使用は、取り付けの緩みやずれが起こらないようにご注意ください。

お問い合わせは
弊社営業本部へ
〒125-0041　東京都葛飾区東金町　1-23-2 澁澤金町ビル 3F
TEL: 03-5672-9830　FAX: 03-5672-9831
E-mail: sales@uchiya.co.jp　Web: http://www.uchiya.co.jp
ウチヤ・サーモスタット株式会社
UCHIYA THERMOSTAT CO., LTD.